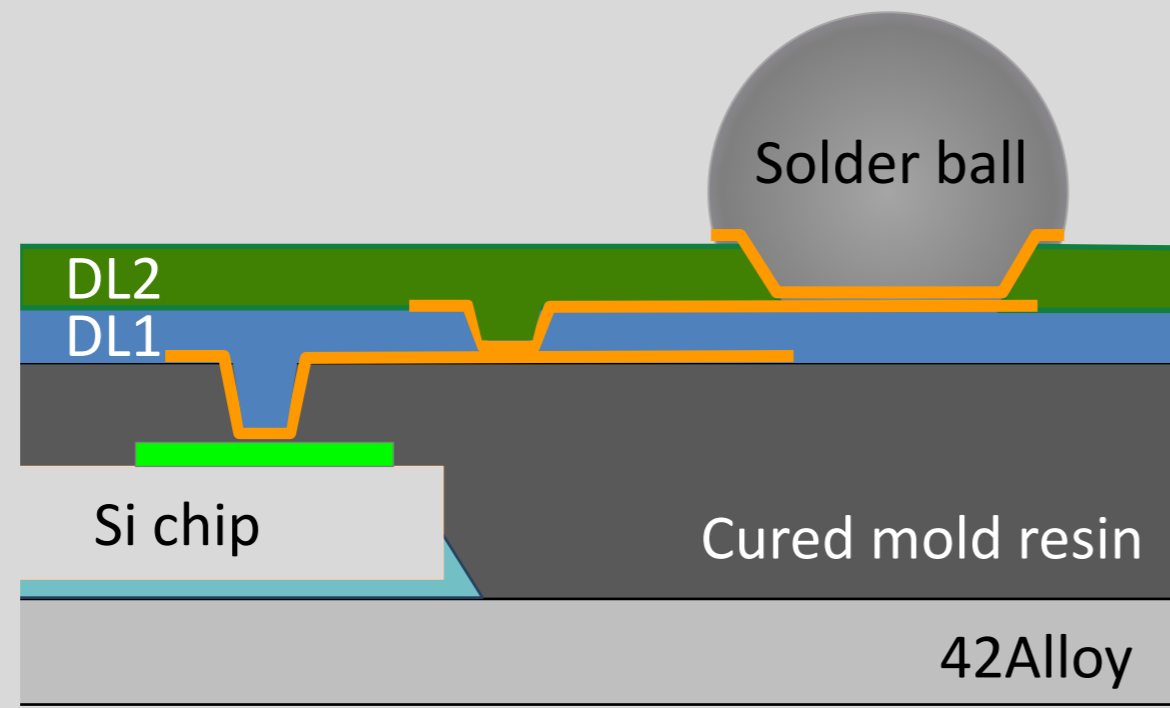
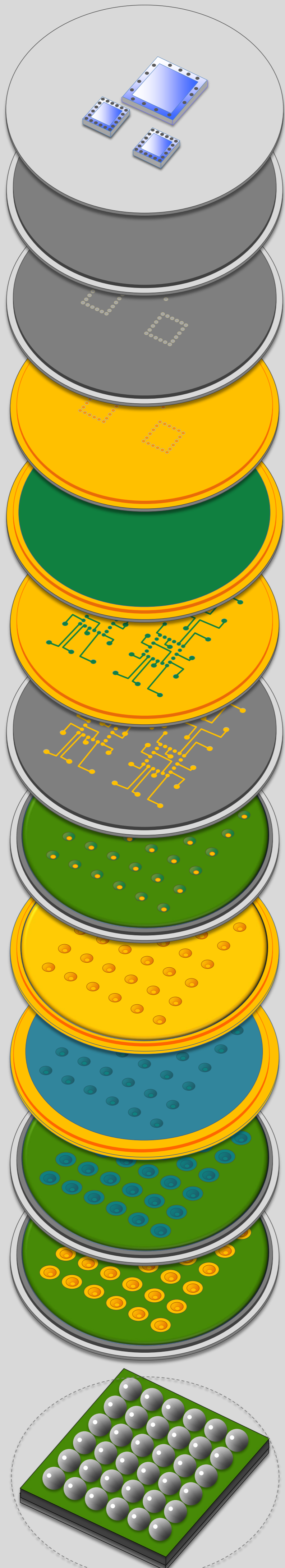


各種System in Packageに対応したプロセス

① RDL – Last 工法



マルチ・チップ搭載
(42Alloy基板)

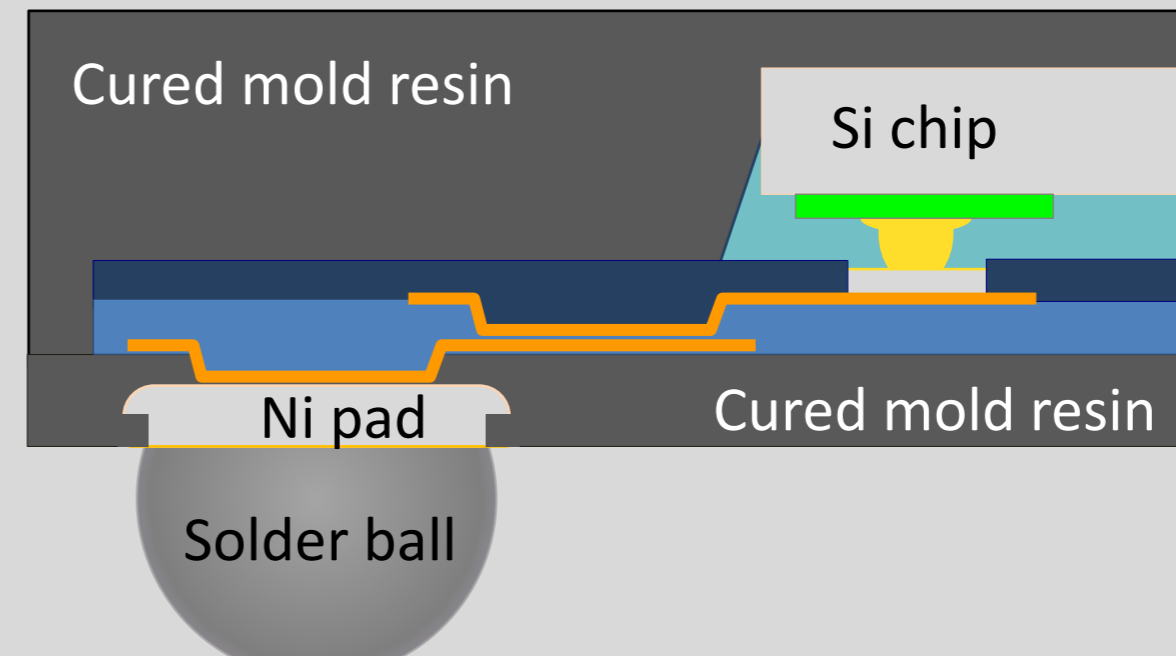


- シード膜スパッタ膜形成
- 銅めっき処理
- エッチングレジスト成膜
- マスクレス露光処理
- 現像処理
- 銅エッチング処理
- エッチングレジスト除去

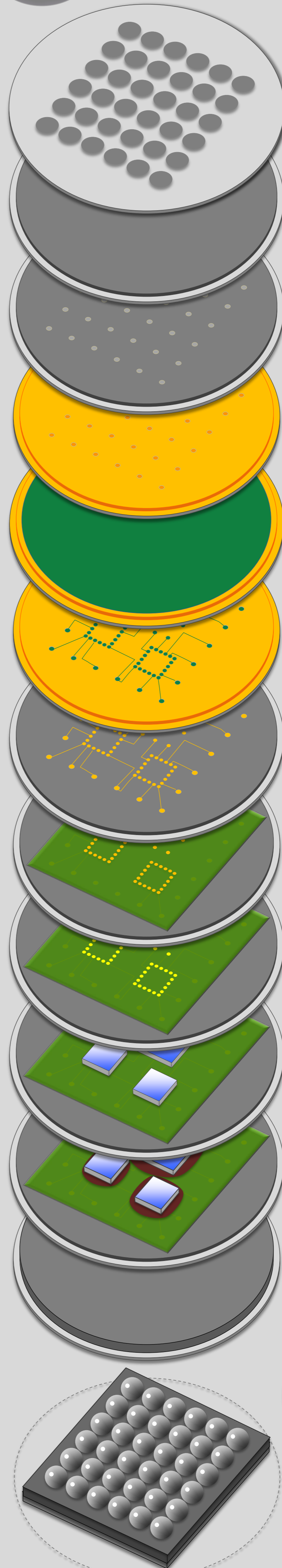
- コンプレッションモールド
- レーザービア加工
- スパッタシード膜形成
- 銅めっき処理
- エッチングレジスト成膜
- マスクレス露光処理
- 現像処理
- 銅エッチング処理
- エッチングレジスト除去
- 絶縁層成膜
- レーザー開口処理

- はんだボール搭載
- はんだリフロー
- ダイシング

② RDL – First 工法

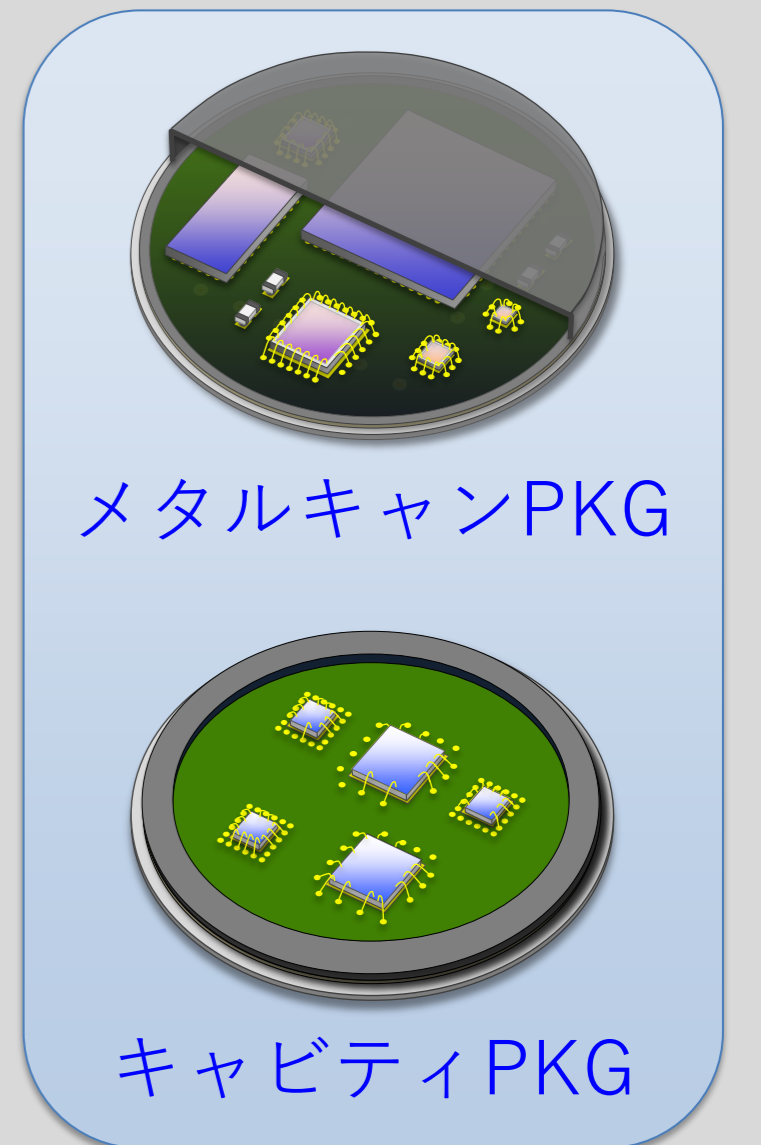


外部電極付き基板



- 無電解ニッケル金めっき処理
- マルチ・チップ搭載
- リフロー&アンダーフィル
- コンプレッションモールド
- SUS板剥離&反転

RDL – First工法
アプリケーション



メタルキャンPKG

キャビティPKG